⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 公開特許公報 (A)

⑪特許出願公開

昭57—82236

①Int. Cl.³
G 11 B 7/24
B 29 D 17/00
G 11 B 3/70
11/00

識別記号 庁内整理番号 7247--5D 7215--4F 7247--5D 7426--5D

❸公開 昭和57年(1982)5月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

砂情報記録担体の複製金型の母型

②特

願 昭55—122624

22出

願 昭55(1980)9月3日

@発 明 者 沖野芳弘

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

切出 願 人

人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

邳代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

明 細 著

1、発明の名称

情報記録担体の複製金型の母型

2、特許請求の範囲

少なくとも表面層が銅またはその合金からなる リレーフ状に情報が担持されていることを特徴と する情報記録担体の複製金型の母型。

3、発明の詳細な説明

本発明は情報記録担体の複製母型に関するものであり、一枚の記録原盤より多くの金型(スタンバ)を作り出す手段を提供することを目的とする。この発明が適用される情報記録離は例えば音声信号が溝状に刻まれた円盤、即ち通常"レコード"と呼ばれる情報担体に対して適用される。本発明の有効性がより効果的に発揮されるのは特に情報密度がオーディオ・レコードに比べて数百倍以上高いと言われるビデオ・ディスクに対してである。その他この種レリーフ状情報を担持する高を配録情報担体の複製金型を製造する手段として効果的に適用される。

現在最もこの種形式の複製が工業的に行なわれているのはオーディオ・レコードの複製においてであるが、ここでは最近実用化が始まった光学方式ビデオ・ディスクの場合を例にとってその工程を説明する。オーディオ・レコードの場合もその記録原業が異なるだけで基本的には全く同じ工程である。

 即ち通常マスタと呼ばれるものが完成する。これは引き続き重クロム酸カリ溶液中に浸漬する等により剥離処理(パッンベーション)がほどこされその表面側にニッケル電鋳6が行われる。(第3図 常マザと呼ばれる。このときマスタ表面は銀であり、マザ表面はニッケルである。次いで制能処理をほどこしてその表明にニッケルで電着させてマザより剥離することによって最終の複製金型(スタンパ)(第4図を得る。

この工程で記録原盤よりマスタの作成は殆んどたった一枚を作るのが従来限度である。一方、マスタからマザ、マザからスタンパは原理的には無限枚数の作成が可能な様に思われる。しかし実際には、その間に母型の劣化が起り担持することが情報とット(レリーフ)が損傷するのでそこかが信号の信号対雑音比ののみしか作製するといてきない。発明者の研究によれば光学方式をディスクにおいて信号対雑音比の劣化の許容

6

以上望むべくは2ミクロン以上の厚さとなるまで 電着させ、その上にニッケル10を通常の手法に より数百ミクロンの厚みで形成させる。このとき 銅の電錫は通常の硫酸銅溶に光沢添加剤を加えて 1~3 A/dm²の電流密度で行うと銅結晶が微細 化し、また内部応力を極小化させて好ましい結果 を得ることができる。また最初の蒸着もしくはス パッタリングによって銅又はその合金を付着させ る工程は、鋼の無電解メッキ法により行うことが できるが結晶が粗大化したり大きな内部応力を発 生することが多いので極力厚みをりすくすること が必要で500オングストローム以下であること が好ましい。更に上記ではバッキングとしてニッ ケルを用いたが銅の電鋳をそのまま引き続き電流 密度を上げて行うこともできる。そのとき内部応 力をおさえるための工程管理に特に注意を払うべ きである。

この様にして作成された鋼表面層 9 を持つマス タは重クロム酸カリ溶液への浸漬等により剥離処 理を行った後、第6 図に示すようにその表面層に 限度を-20IB以内とすればおよそ5~10枚が限度である。仮に10枚としても1枚の記録原解から作成可能なスタンパ数は歩留まり100%と仮定して10×10=100(枚)にしかすぎない。実際には金型複製における母型劣化は特にマスタの鉄面で起り易く、いわゆる鍛のハガレやサビの発生によって得ることができるスタンパの数は上記の光~¼にしかすぎず、現行のプレス方式でディスクを生産する場合、一原雑よりの複製可能枚数は良く管理された工程においても数万枚以下である。

本発明は上記の問題を克服して一記録原雑より、 より多くの良質な複製金型を作る手段を提供する ものである。

本発明の一実施例を以下に述べる。まづ、第1 図じ構成よりなる記録原盤の表面上に第5図に示すように蒸着もしくはスパッタリングによって 200~5000オングストロームの厚さで銅あるいは銅の合金を付着させる。次いで、電鋳法により銅の階9の厚みが5000オングストローム

6 ._

再び銅あるいは鋼合金11の電着を行う。そのとき特に鋼あるいは鋼合金11の表面層の厚みが数千オングストローム位まで形成されるまで結晶の 微細化及び内部応力の極小化に留意を払うで ある。その後は前記の従来の工程と同じでニッケル電鋳によりバッキング12をほどこして剥離するとにより第二の母型、即ちゃぜを作成することができる。なお、表面層11の電着は第一の母型作成と同様、蒸着やスパッタリングによって可能である。

かくして得られた表面に鋼あるいは鋼合金層 11を持つマザは前記同様剥離処理をほどこし、 第7図に示すようにその表面層にニッケル電着を 行い所定の厚さまでニッケル層13を形成してディスク複製金型であるスタンパを作成することが できる。

発明者の注意深い研究によれば、このようにして出来たマスタ及びマザからは再生信号劣化の許容限度を信号対雑音比で-20IBとすると、約百枚の転写複製が可能であるとの結論が得られた。

この理由については現在さらに研究中であるが、 一つの推測として銅そのものが元来化学的に活性 な金属であるため、剥離処理が優めて均一に効果 的に行われることと、ニッケルに比較してやわら かく、ねばりという銅の物理的性質に起因してい ると思われる。

かくして本発明によれば、一記録原盤より 100×100=1万(枚)の複製金型の作成が 容易に可能となるので、従来の100~400倍 程度のスタンパが安定に作成でき、工業的に言っ て一プログラムに一枚の原盤を作成すればよいと とになる。

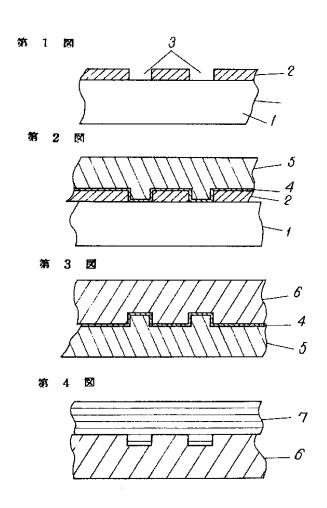
4、図面の詳細な説明

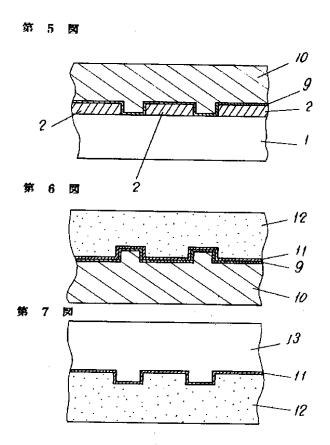
第1図は記録原経の一部を示す断面図、第2図は従来の原盤からマスタの作成工程を説明するための断面図、第3図は従来のマスタからマザの作成工程を説明するための断面図、第4図は従来のマザからスタンパの作成工程を説明するための断面図、第5図は記録原盤から本発明の複製金型の母型(マスタ)を作成する工程を示す断面図、第

6図は本発明による母型(マスタ)より更に母型 (マザ)を得る工程を示す断面図、第7図は本発 明による母型(マザ)よりスタンパを得る工程を 示す断面図である。

1……ガラス板、2……レジスト膜、3……ピット、9,11……銅,銅合金層、10,13……ニッケル隣₀

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名





PAT-NO: JP357082236A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57082236 A

TITLE: MOTHER MOLD OF DUPLICATED

METALLIC MOLD FOR

INFORMATION RECORDING

CARRIER

PUBN-DATE: May 22, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

OKINO, YOSHIHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP55122624

APPL-DATE: September 3, 1980

INT-CL (IPC): G11B007/24 , B29D017/00 ,

G11B003/70 , G11B011/00

US-CL-CURRENT: 205/68

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce the deterioration of the surface at transfer and reproduction, by providing a copper or copper alloy on the surface, in a master and a mother such as video disc.

CONSTITUTION: On the surface of a recording mother disc consisting of a glass plate 1 and a residual resist film 2, copper or copper alloy having 200~5,000Å thickness is stuck by vapor deposition or sputtering. Next, a copper layer 9 is electrically deposited as far as $\geq 2\mu$ by the electrotyping method and nickel 10 is formed thereon in several hundreds μ thickness. After the master 10 having the copper surface layer 9 is peeled off with immersion to potassium dichromate solution, a copper 11 is electrodeposited further on the surface layer 9. The backing 12 is made with nickel electrotyping for peeling, allowing to form a mother 12 with a copper surface layer 11.

COPYRIGHT: (C) 1982, JPO&Japio